

A photograph of the Purdue University entrance sign, which is a large, arched structure with the words "PURDUE UNIVERSITY" in capital letters. The sign is set against a backdrop of a clear blue sky and some buildings on the university campus. In the foreground, there is a paved walkway and some flower beds with yellow and purple flowers. A large yellow rectangular overlay covers the left side of the sign. Inside this overlay, the text "PURDUE DSCIC INTERNSHIP 2024 I" is written in white, sans-serif capital letters.

PURDUE DSCIC INTERNSHIP 2024 I

PURDUE  
UNIVERSITY

West Lafayette, Indiana

PURDUE ENGINEERING

**#4**

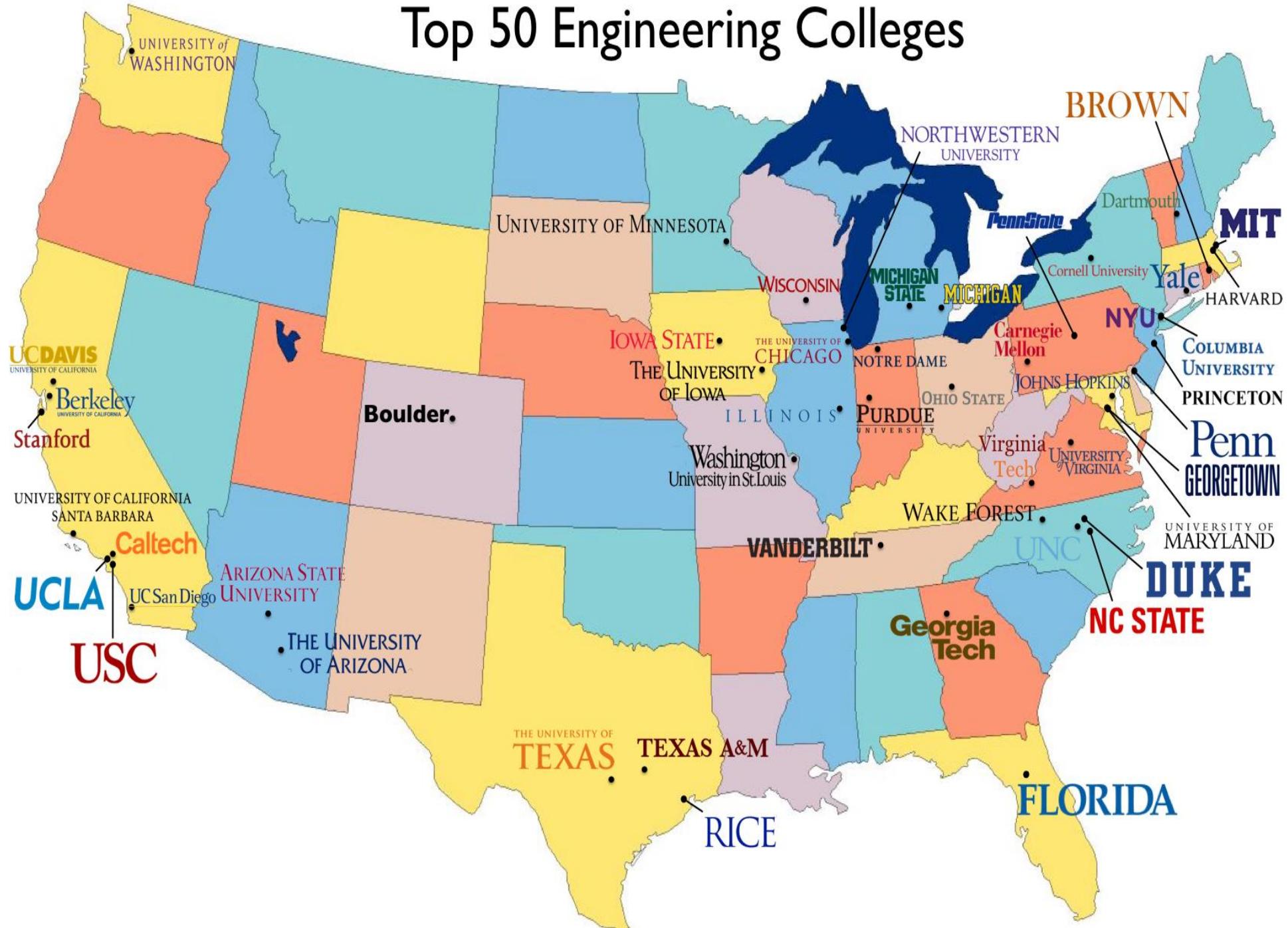
**GRADUATE  
ENGINEERING**  
IN THE U.S.

U.S. NEWS & WORLD REPORT (2023)

*Back-to-back Top 4 in the U.S. for the first time.*



# Top 50 Engineering Colleges



# Vive la experiencia Purdue

**Purdue University** es una de las universidades más prestigiosas en el campo de las ciencias e ingeniería. Está ubicada en la zona de influencia de la ciudad de Indianápolis, considerada el Hub Industrial-Logístico de USA.

El programa **“Purdue DSCIC Internship”** consiste en ocho (8) semanas de pasantía en un proyecto de innovación y tecnología en el ecosistema de Purdue University.

Los pasantes serán dirigidos por un equipo de profesores y alumnos de Purdue University.

El formato del programa será híbrido: siete (7) semanas en modalidad remota y una (1) semana presencial en el campus de la universidad.



# Plana Expertos



**Steve Dunlop**  
Managing Director  
*GSCMI Global Supply  
Chain Management  
Initiative*  
*DCMME Dauch Center for  
Management of  
Manufacturing Enterprises*  
*Daniels School of  
Business*



**Gary Mercado**  
Senior Scientist  
*Krenicki Center Business  
Analytics & Machine  
Learning*  
*Daniels School of  
Business*



**Roy Vasher**  
Senior Advisor & Faculty  
*GSCMI & DCMME*  
*Daniels School of  
Business*



**Eduardo Huerta-Mercado**  
Research Scholar  
*Burton D. Morgan Center for  
Entrepreneurship*  
*Discovery Park*  
  
Senior Advisor  
*GSCMI & DCMME*  
*Daniels School of Business*

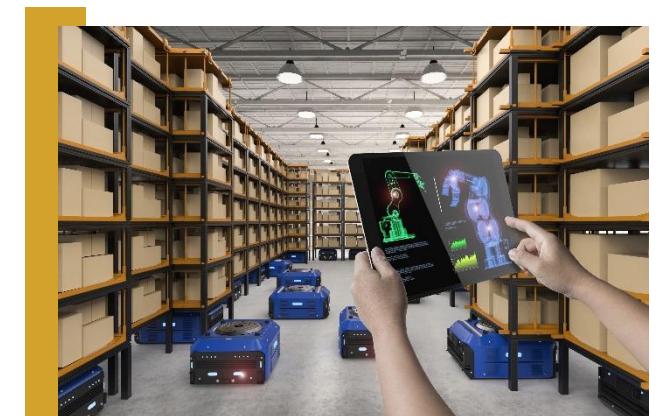
# Alcance de los Proyectos

Los prototipos estarán basados en la aplicación de modelos de innovación y tecnología en la **Cadena de Suministro y Manufactura** para incrementar productividad y reducir costos.

Las tecnologías incluirán Data Analytics, Simulación, Internet de las Cosas, Inteligencia Artificial, Realidad Virtual y Aumentada (AR/VR), NoCode Apps, etc.

El alcance de los prototipos podrá considerar, por ejemplo:

- Desarrollo de NoCode Apps para gestión de proyectos
- Modelo de Data Analytics Electrical Vehicles
- Videoanalítica para gestión de almacenes.
- Modelo de optimización de Transporte.



# Plan de Actividades

02 al 27 de octubre 2023

- Convocatoria
- Inscripciones

30 de octubre al 15 de diciembre 2023

- Orientación de pasantes
- Guía y autoestudio de herramientas y tecnologías
- Asignación de proyectos

8 de enero al 1 de marzo 2024

- Entrenamiento en el trabajo
- Ejecución del proyecto (remoto)

4 al 8 de marzo ( 1 semana )

- Misión académica al campus Purdue
- Ejecución del proyecto ( presencial )



# PROGRAMA

## Lunes 4 de marzo

Bienvenida y Conferencia: TP3 – Manufactura y Logística Inteligentes

*Steve Dunlop, GSCMI- DCMME  
Daniels School of Business*

Laboratorio de Logística Digital DSCIC:  
*Tecnologías Disruptivas*

Tour del Campus  
Daniels School of Business  
Purdue Memorial Union

Almuerzo

Sesión de Proyectos  
*Desarrollo de pasantía*

## Martes 5 de marzo

### Tour del Campus

*Purdue Mall, Bell Tower, Engineering  
Neil Armstrong Hall*

### SAI Subaru of Indiana Automotive

*Visita guiada: JIT, 5S, Robotics  
Automotriz – Planta de Ensamble*



Almuerzo

### Sesión de Proyectos

*Desarrollo de pasantía*

## Miércoles 6 de marzo

Taller: Tendencias en Supply Chain Digital

*Eduardo Huerta-Mercado Herrera  
Daniels School of Business*

Bechtel Design Innovation Center

*Fabricación Aditiva y Subtractiva  
Proyectos Integrados de Tecnología*

Industrial Engineering “Gateway”

*Laboratorios de Ingeniería Industrial*

Almuerzo

NHK of America

*Visita guiada: JIT, 5S  
Lean Manufacturing*



# PROGRAMA

Jueves 7 de marzo

Taller : Data Analytics aplicada

*Dr. Gary Mercado*

*Daniels School of Business*

BIRCK Nanotechnology Center

*Laboratorio de Nanotecnología*

Almuerzo

**Wabash National**

*Visita guiada: Lean Manufacturing*

*Fabricación y Ensamble Trailers*



Sesión de Proyectos

*Desarrollo de pasantía*

Viernes 8 de marzo

Presentación de Proyectos Purdue DSCIC

*Internship 2024 – I*

Ceremonia de Clausura y Entrega de Certificados

Tarde Libre

Cena despedida

Sábado 9 de marzo

Transporte Aeropuerto

Regreso a Lima



# Costo del Programa

- El costo del programa asciende a:
  - 3,800.00 USD (habitación individual)
  - 3,400.00 USD (habitación doble compartida)El pago se realiza mediante transferencia internacional a banco de USA
- El programa incluye:
  - Supervisión y monitoreo de la Pasantía (del 30 de octubre 2023 al 8 de marzo 2024)
  - Misión académica Purdue University (del 4 al 8 de marzo 2024)
    - Alojamiento en Hotel, desayuno incluido: a 5 minutos del campus ( 6 noches )
    - Conferencias magistrales y talleres
    - Visitas guiadas a los Centros de Innovación de Purdue University
    - Visitas guiadas a empresas SIA, Wabash National y NHK
    - Transporte desde y hacia el aeropuerto Indianápolis (IND) o Chicago (ORD)
    - Transporte local a las actividades
  - Certificado de participación emitido por Purdue University***
- El participante deberá gestionar: (costos aproximados)
  - Pasaje aéreo = 700 USD
  - Seguro de viaje= 40 USD
  - Alimentación (6 días) = 300 USD

# Beneficios para el participante



- Colaboración con una de las más prestigiosas universidades del mundo, líder en Ciencia y Tecnología.
- Transferencia de conocimiento de modelos de gestión y tecnologías de punta aplicados a las operaciones de manufactura y logística.
- Posicionamiento de liderazgo y referencia en Innovación y Tecnología a nivel local e internacional.
- Experiencia de ejecución de proyectos en empresas referentes de USA.
- Certificado de Participación emitido por GSCMI / DCMME – Daniels School of Business.
- Membresía “DSCIC Silver Professional Membership”

On Campus

A large, dark blue rectangular sign with the word "PURDUE" in large white capital letters. Below it, the word "UNIVERSITY" is written in smaller yellow capital letters. The sign is set against a background of autumn foliage with yellow and orange leaves.

PURDUE  
UNIVERSITY

Eduardo Huerta-Mercado Herrera

[ehuertamercado@bsdla.com](mailto:ehuertamercado@bsdla.com)

[huertame@purdue.edu](mailto:huertame@purdue.edu)

M +51 936833074

M +1 (765) 775 6806

West Lafayette, Indiana